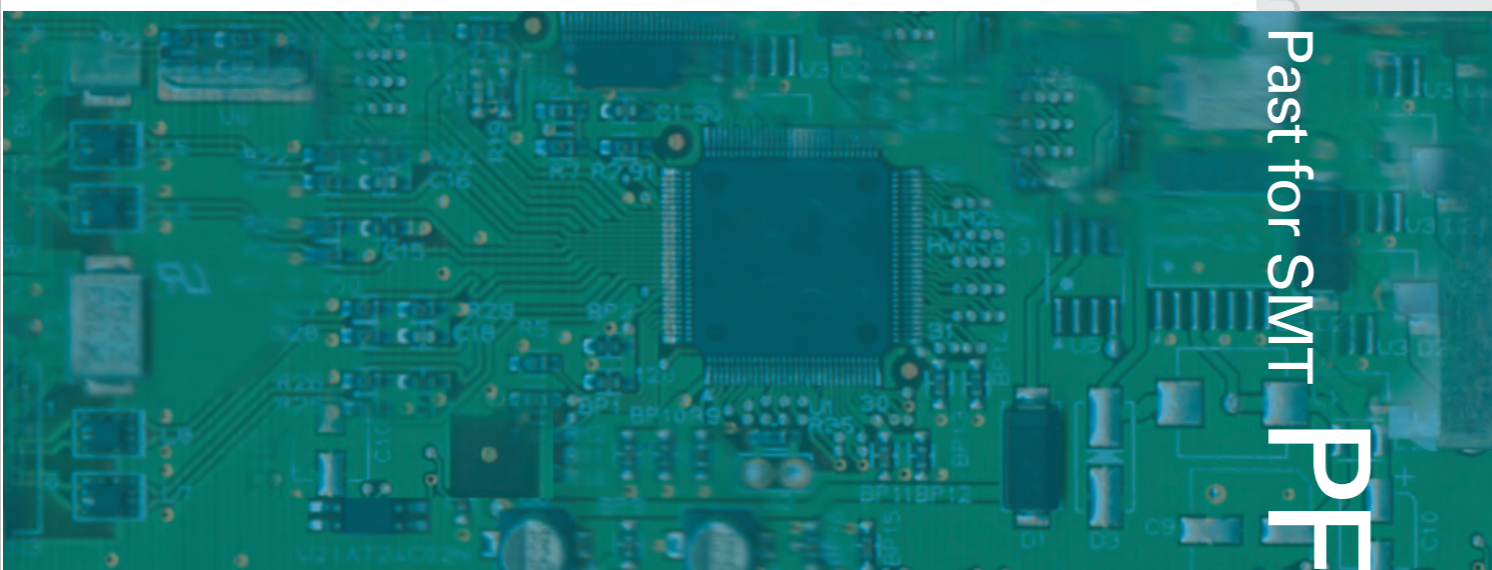


PF305-140TO

SMT用鉛フリーソルダペースト

ハロゲンフリータイプ

- ハロゲンフリーでありながら優れたボイド抑制効果。
The excellent reduced void even by the halogen free.
- 優れた加熱ダレ防止効果を継承。
The excellent avoided heat slumping.



Halogen Free Type Solder

Past for SMT

PF305-140TO

● 一般特性 General characteristics

項目 Items	代表特性 Typical Property	試験方法 Test method
合金組成 Alloy composition	Sn-3.0Ag-0.5Cu	-
粒度 Particles Size	20~38 μm	-
フラックス含有量 Flux content	11.5%	JIS Z 3197
ハロゲン含有量 Halide content (chlorine conversion)	0.02%	配合値 Blend Value
銅板腐食試験 Copper plate corrosion test	Pass	JIS Z 3284
クロム酸銀試験 Silver chromate paper test	Pass	JIS Z 3197
銅鏡試験 Copper mirror test	Pass	JIS Z 3197
絶縁抵抗試験 Electric insulation resistance test, SIR	40°C90%RH	3.8 × 10 ¹² Ω
	85°C85%RH	1.6 × 10 ¹⁰ Ω
100g以上粘着保持時間 Tackness time of keeping 100g (50kN/m ²) minimum	16 hours	JIS Z 3284
流動特性 Fluidity	粘度 Viscosity	195 Pa·s
	Ti値 Thixotropic index	0.52

上記特性値は代表値で保証値ではありません。The physical property values of above are not the specification of the product.

PF305-140TO

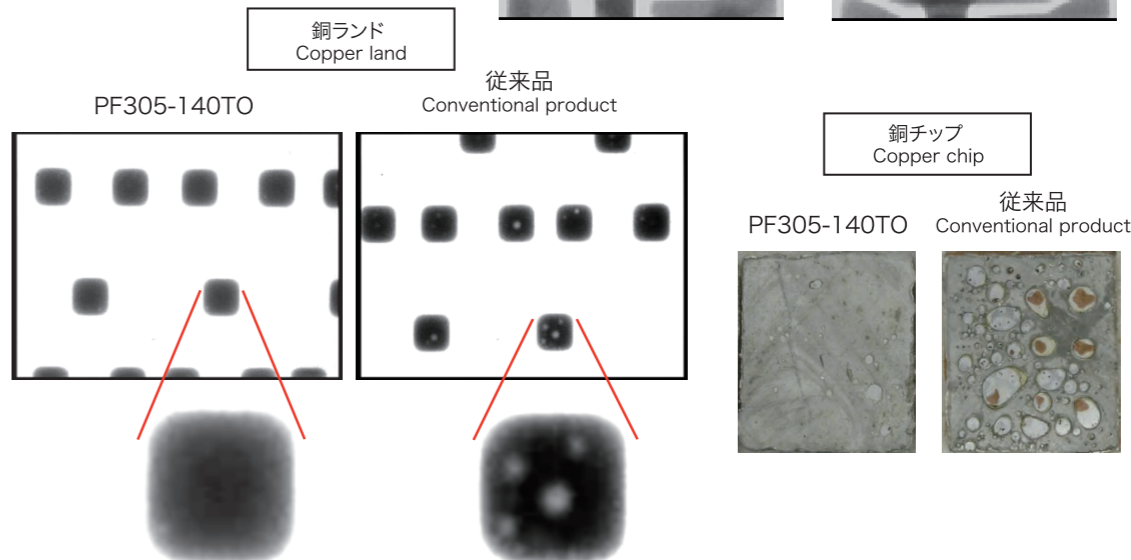
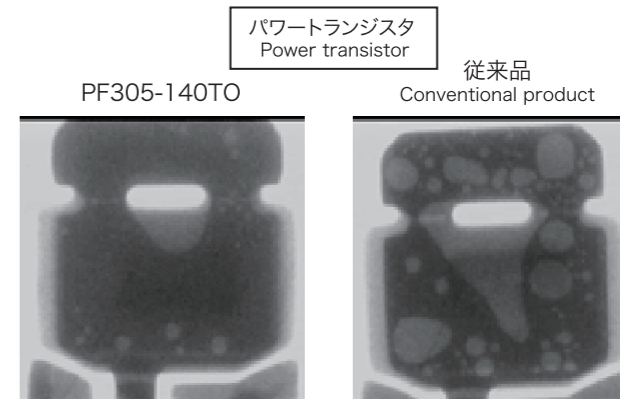
SMT用鉛フリーソルダペースト

ハロゲンフリータイプ

ハロゲンフリーでありながら優れたボイド抑制効果
The excellent reduced void even by the halogen free

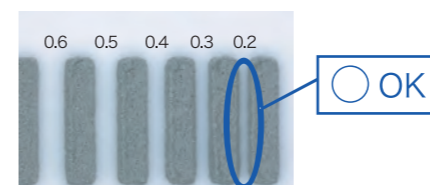
電子機器における
ハロゲンフリーの要求
The electronic applications required
for halogen free.
塩素 (Cl) < 900 ppm
臭素 (Br) < 900 ppm
合計 Total < 1500 ppm

予備加熱 Preheating : 150~190°C 90sec
ピーク温度 Peak temperature : 240°C

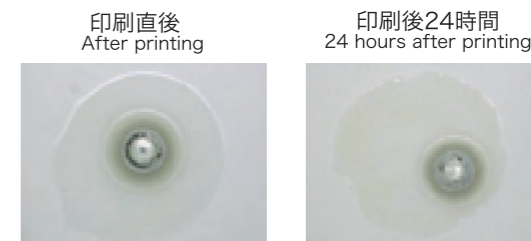


優れた加熱ダレ防止効果
The excellent avoided heat slumping

優れたはんだボール防止効果
The excellent prevented solder ball



予備加熱ダレ試験 (150°C)
Preheat slumping test
(JIS Z 3284)



はんだボール発生なし
No solder ball

試験基板 Test Board : セラミック板 Ceramics
予備加熱 Preheating : 150°C 60sec
ピーク温度 Peak temperature : 260°C
(JIS Z 3284)

Halogen Free Type Solder Past for SMT

PF305-140TO